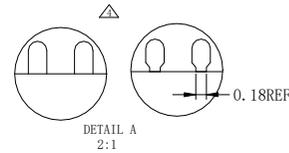
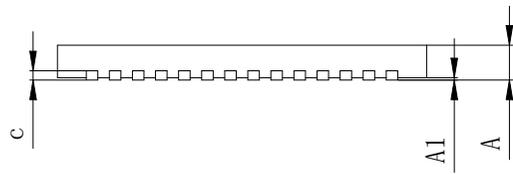


BOTTOM VIEW



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	0.70	0.75	0.80
	0.80	0.85	0.90
A1	—	0.02	0.05
b	0.18	0.25	0.30
c	0.18	0.20	0.25
D	7.90	8.00	8.10
D2	6.55	6.65	6.75
e	0.50BSC		
Ne	6.50BSC		
Nd	6.50BSC		
E	7.90	8.00	8.10
E2	6.55	6.65	6.75
L	0.35	0.40	0.45
h	0.30	0.35	0.40

△	增加DETAIL A图示	何璐	2021.3.11
△	增加0.85的封装厚度	郭玲芝	2018.2.12
△	更改公司名称	李方霞	2011.7.5
△	更改公司名称	李新锋	2011.3.3
更改标记	更改内容	签名	日期

华天科技（西安）有限公司 △△△
HuaTian Technology (Xi'an) CO., LTD

QFN56L (0808X0.75-0.50) QFN56L (0808X0.85-0.50) 产品外形图	图号:HTFX056080801		
	单位	版次	密级
	mm	4版	秘密
第 1 张		共 1 张	

参考图号 JEDEC MO-220 (VLLD-5/WLLD-5)

拟 制		复 审	
审 核		会 签	
制 图		标 准 化	
幅 面: A4		批 准	
		比 例:	

